

PLCC



FEATURES

- ▶ ボディサイズ : 0.352" x 0.352" ~1.152" x 1.152"
- ▶ リード数 : 20~84
- ▶ JEDEC標準準拠
- ▶ 狭ピッチワイヤボンド対応

APPLICATIONS

AmkorのPLCC製品ファミリーは「J」リード表面実装パッケージのJEDEC標準を満たすように設計されています。本パッケージは、マイクロコントローラ、ASIC、電源コントローラなど、さまざまなデバイスに使用されます。アプリケーションとしては民生品および工業向け製品に適しています。

AmkorのPLCC (Plastic Leaded Chip Carrier) は、20~84リードの正方形タイプおよび32リードの長方形タイプをラインアップしており、市場で求められる幅広いニーズにお応えします。本パッケージファミリーには、RoHS準拠で鉛フリーかつ環境に優しいグリーン材料を使用しています。

Thermal Performance

マルチレイヤーPCB

Package	Body Size (mm)	Pad Size (mm)	θJA at (°C/W) by Velocity (LFPM)		
			0	200	500
28 Ld	11.5 x 11.5	6.6 x 6.6	37.8	32.1	29.4
44 Ld	16.6 x 16.6	8.89 x 8.89	29.6	24.4	22.0
84 Ld	29.3 x 29.3	10.8 x 10.8	22.2	19.4	18.1

JEDECテストボード - 1S2P

テスト @ 1W、ドロップインヒートスプレッダーオプションあり

Electrical Performance

シミュレーション @ 100 MHz

Package	Body Size (mm)	Pad Size (mm)	Lead	Self Inductance (nH)	Bulk Capacitance (pF)	Self Resistance (mΩ)
20 Ld	8.9 x 8.9	3.7 x 3.7	Longest Shortest	2.110 1.780	0.596 0.583	13.5 11.1
44 Ld	16.6 x 16.6	8.89 x 8.89	Longest Shortest	2.900 2.140	0.893 0.681	17.8 13.7
84 Ld	29.3 x 29.3	10.8 x 10.8	Longest Shortest	10.900 6.840	1.780 1.750	57.6 43.2

Reliability Qualification

AmkorのPLCCパッケージは、標準的なJEDECのテスト基準に対応した実績のある信頼性の高い部材を用い、最適化されたパッケージデザインで製造されています。

- ▶ MSL : JEDEC Std D level 3, 30°C/60% RH, 192 hrs
- ▶ 温度サイクル : -65°C/+150°C, 500 cycles
- ▶ uHAST : 130°C/85% RH, 1000 hours
- ▶ HTS : 50°C, 1000 hours

PLCC

Process Highlights

- ▶ チップ厚：25 mils
- ▶ ストリップメッキ：100%無光沢Sn
- ▶ ストリップマーキング：レーザー
- ▶ リード検査：光学検査

Test Services

- ▶ プログラム作成／コンバージョン
- ▶ プロダクトエンジニアリングサポート
- ▶ ウェハプローブ
- ▶ -55°C～+165°Cテスト対応

Shipping

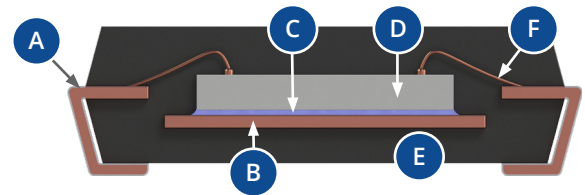
- ▶ 帯電防止クリアチューブ

Configuration Options

PLCC Nominal Package Dimensions (mm)

Package Type	Lead Count	Body Size	Body Thickness	Lead Pitch	Lead Form	Amkor DWG #	JEDEC	Units Per Tube
Square	20	0.352 x 0.352	0.152	0.05	N/A	00060	MS-018	46
	28	0.452 x 0.452	0.152	0.05	N/A	00060	MS-018	37
	44	0.652 x 0.652	0.152	0.05	N/A	00060	MS-018	26
	52	0.752 x 0.752	0.152	0.05	N/A	00060	MS-018	23
	68	0.952 x 0.952	0.150	0.05	N/A	00060	MS-018	18
	84	1.152 x 1.152	0.150	0.05	N/A	00060	MS-018	15
Rectangular	32	0.452 x 0.552	0.109	0.05	N/A	00061	MS-016	30

Cross Section PLCC



- A J-formed Cu leadframe
- B Die attach pad
- C Die attach adhesive
- D Die
- E Mold compound
- F Wire



詳細についてはamkor.comにアクセスしていただくか、またはsales@amkor.com までメールをお送りください。

本文中の情報に関して、Amkorはそれが正確であることまたは係る情報の利用が第三者の知的権利を侵害しないことについて、如何なる保証も致しません。Amkorは同情報の利用もしくはそれに対する信頼から生じた如何なる性質の損失または損害についても責任を負わないものとし、また本文書によって如何なる特許またはその他のライセンスも許諾致しません。本文書は、如何なる形でも販売の標準契約条件の規定を超え、如何なる製品に対しても、Amkorの保証を拡張させ、または変更することはありません。Amkorは通知することなくいつでもその製品および仕様に変更を行う権利を留保します。Amkorの名前とロゴはAmkor Technology, Inc.の登録商標です。記載されている他の全ての商標はそれぞれの会社の財産です。© 2019 Amkor Technology, Incorporated. All Rights Reserved. DS293H-JP Rev Date: 08/19